

EMSD-588A&B

有机硅电子凝胶

产品特征

◇ EMSD-588A&B是一种有机硅电子凝胶。本产品由A，B双组分构成，A和B组分以1：1比例混合。产品在室温下就可以固化，当加热时，可以使固化速度加快。本产品有优异绝缘性能，高透光性，能在-50~200°C保持弹性，也符合RoHS。本产品适合用于LED灯条灌封或对纯度很高的电子产品有长效的防潮和防大气污染保护以及精密电器线路以及混合电路的保护，小型电器的灌封保护。

产品参数

固化前	
外观	A组分 透明液体 B组分 透明液体
25 °C粘度, mPa. s	A组分 3000 B组分 2000
密度, g/cm ³	0.97
配比 1:1	操作方便, 误差小

固化(按照重量比或者体积比1: 1混合)	
25 °C粘度, mPa. s	2500
25 °C下工作时间, 分钟	90
50 °C下工作时间, 分钟	45
130 °C下工作时间, 分钟	7

固化后 (150 °C下 滤纸上 测试24小时)	
硬度 (Shore A)	35
拉伸强度 Mpa	3.1
断裂延长率 (%)	85
电性能, 150 ° C下固化1小时	
击穿电压, kV/mm	15
体积电阻, Ohm. cm	3.0×10^5
环保认证	RoHS

The information and statements herein are believed to be reliable but are not to be construed as a warranty or representation for which we assure legal responsibility. Users should undertake sufficient verification and testing to determine the suitability for their own particular purpose of any information or products referred to herein. No warranty of fitness for a particular purpose is made. Properties are typical and not to be used as specifications.

使用说明

1. 确认被保护材料清洁干燥。
2. 确认两个组份按照体积比或者重量比 1: 1 混合，建议真空（10-20mm 汞柱）下抽 5-10 分钟。
3. EMSD-588A&B 按照推荐比例混合后，在 >25 °C 的温度下让它逐渐固化。
4. 作时尽量避免带入空气，对复杂外形的线路板建议真空灌封。

注意事项

在使用 EMSD-588A&B 的过程中，特别注意不要和以下物质接触，否则会导致产品固化不完全或者甚至不固化：

- 有机锡
- 含有机锡的有机硅产品
- 含硫的物质
- 胺基，聚胺脂，酰胺及叠氮化物

包装

EMSD-588A&B 通常采用 18 kg+18 kg 包装。

储存与产品保质期

未经开封的 EMSD-588A&B 产品可以在室温储存的条件下 24 个月存储。产品一旦开封应当尽早使用完。

安全

请参考本产品的材料安全数据表。

The information and statements herein are believed to be reliable but are not to be construed as a warranty or representation for which we assure legal responsibility. Users should undertake sufficient verification and testing to determine the suitability for their own particular purpose of any information or products referred to herein. No warranty of fitness for a particular purpose is made. Properties are typical and not to be used as specifications.